三菱マテリアル

# ECTC(2025/5/27-30@米国･ダラス)出展のご案内

三菱マテリアル株式会社は、100%子会社の米国三菱マテリアル株式会社と共同で5月28日(水)～29日(木)に米国･ダラスにて開催される半導体関連学会「ECTC(2025 IEEE 75th Electronic Components and Technology Conference)(英語)」に併設の展示会に出展致します。

また、30日(金)のProgram Sessionでは、弊社の先端パッケージング向けに開発中のナノポーラスCuめっき液について「A Study About Bonding Properties With Multilayer Porous Structures for Fine Pitch Interconnection」というテーマで講演を行う予定です。

ECTCは半導体関連を中心としたパッケージング、電子部品、マイクロエレクトロニクスシステム等幅広い分野の技術者が一堂に集い、最先端の技術、動向、情報を発信する世界最大級の国際学会です。

本学会に併設される展示会において、当社は「人と社会と地球のために、循環をデザインし、持続可能な社会を実現する ～ Circulating resources for a sustainable future ～」というスローガンのもと、世界的に高シェアを誇るバンプ形成用低α線 Pb フリーはんだめっき液や AuSn 合金ペーストに加え、開発中のナノポーラス Cu めっき、大型角型 Si 基板材等の半導体関連製品をご紹介させていただく予定です。

本学会にお越しの際は、是非弊社発表の聴講、並びに当社ブースにお立ち寄りください。

**プログラム**

75-ECTCFinal-Web.pdf

**出展期間**

2025年5月28日（水） ～29日（木）
5月28日 9:00am–12:30pm, 2:00 –6:30pm
5月29日 9:00am–12:30pm, 2:00 -4:00pm

**会場**

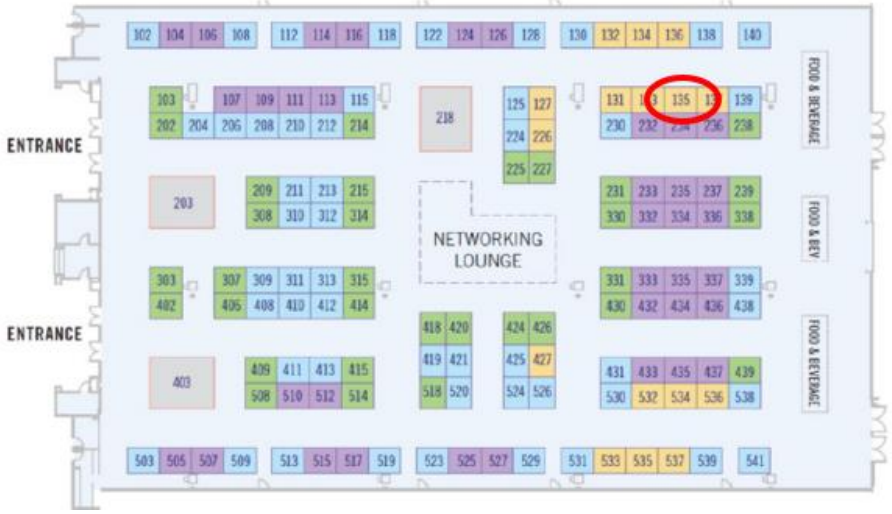
Gaylord Texan Resort &Convention Center
1501 Gaylord Trail, Grapevine, Texas, USA, 76051
当社ブース番号： 135

お問い合わせ先
Mitsubishi Materials U.S.A. Corporation
Electronic Materials and Components Division, Electronics Materials Department
E-mail: electronicmaterials@mmus.com

三菱マテリアル

## 2025 ECTC EXHIBITION

**Exhibit Hall Hours**

**Wednesday, May 28**
9:00 a.m. – 12:30 p.m. & 2:00 p.m. – 6:30 p.m.

**Thursday, May 29**
9:00 a.m. – 12:30 p.m. & 2:00 p.m. – 4:00 p.m.